



EIPC European Institute of Printed Circuits

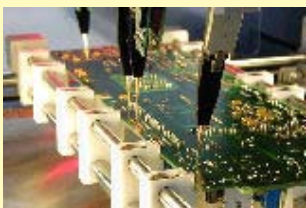
Workshop: Entwicklungen von starren und starr-flexiblen Leiterplatten mit eingebetteten Bauteilen



The EIPC is the European representative at the WECC



www.surfenergy.eu



Programmschwerpunkte:

- Neue Designoptionen für verbesserte Technologien
- Neue Basismaterialien für höhere Zuverlässigkeit
- Neue Bauteile und Bauteilformen zur Miniaturisierung
- Neue Herstellungsverfahren Fertigungstechnologien
- Zukünftige Entwicklungen und Tendenzen
- Besichtigung der modernen Bestückungslinien von BuS

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

Zielsetzung:

Der Workshop soll die Kommunikation zwischen Elektronikdesignern, den Materiallieferanten, den Leiterplattenherstellern, den Bauteillieferanten und der Bestückungsindustrie intensivieren und aufzeigen, welche technischen Innovationen die Anwender in Zukunft bei den Bauteilen, den Materialien und den Verarbeitungstechniken zu erwarten haben. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland und Europa soll durch das Aufzeigen neuer Technologien und Produktionswege ausgebaut bzw. gefestigt werden.

Wer sollte teilnehmen?

- **Leiterplattenentflechter** erhalten die Möglichkeit zu lernen, wie Änderungen im Design einen Einfluß auf die Baugruppen haben.
- **Lieferanten von Basismaterial, Bauteilen und Prozesschemie** sowie von Verfahrenstechniken werden über Produkte informiert, die in Zukunft benötigt werden.
- **Leiterplattenhersteller** erhalten Informationen über die Weiterentwicklung von Bauteilen für das Einbetten in Leiterplatten und erfahren, welchen Einfluss diese Entwicklung auf zukünftige Baugruppen haben wird.
- **Baugruppen-Hersteller und Nutzer (EMS / OEMs / ODMs)** werden über zukünftige Entwicklungen informiert und haben so die Möglichkeit, für neue Projekte fortschrittliche Lösungen mittels Einbetten von Bauteilen in Leiterplatten während der Planungsphase mit zu berücksichtigen.

Veranstaltungsort: BuS Elektronik GmbH & Co. KG

Riesa, Deutschland

Datum: 06. Oktober 2010

Zeit: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Sprache: Deutsch

Sponsors:

isola

Press Sponsors:

evertiq

PCB

PRODUKTION VON
PL
US
SYSTEMEN

PCB007

Circuitree

For more information contact EIPC: Ms. S. Derhaag,
Bourgognestraat 16, NL-6221 BX Maastricht, Internet: www.eipc.org
Tel: +31-43-3440872, Fax: -73, e-mail: sderhaag@eipc.org

Programm

Entwicklungen von starren und starr-flexiblen Leiterplatten mit eingebetteten Bauteilen

09:00	Registrierung und Workshop Teil 1	
09:30	Begrüßung und Einführung durch EIPC und BuS Elektronik, eine führende EMS Firma in Europa	Dr. Konrad Wundt, EIPC, Dr. Witte , BuS Elektronik GmbH & Co. KG, DE
10:00	Die IPC-, JISSO- und iNEMI-Roadmap für die Elektronikindustrie mit Informationen über den Stand der Entwicklungen in Japan und über neue Standards für Leiterplatten mit eingebetteten Bauteilen	Michael Weinhold, EIPC, DE
10:20	Kostenstruktur in der Baugruppenfertigung mit Ausblick auf die Mehrebenenbestückung	Dr. Werner Witte, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, DE
10:40	Passive Bauelemente zum Einbetten in Leiterplatten. Was muss bei der Verarbeitung berücksichtigt werden?	Norbert Bauer, Murata Elektronik GmbH, DE
11:00-11:30	Kaffeepause und Gespräche mit den Teilnehmern	
11:30	Richtige Auswahl von Basismaterial	Rainer Taube, Taube Electronic GmbH / FED, DE
11:50	Basismaterial für hochtemperaturfeste und hochzuverlässige Baugruppen. Was sind die Vorteile?	Gerhard Horst, Isola GmbH, DE
12:10	Lötbar Oberflächen. Welche sind für die einzelnen Baugruppen mit Mehrfachlötungen besonders geeignet	Nils Arendt, Enthone GmbH, DE
12:30	Innovative Produkte durch flexible und starrflexible Schaltungen	Markus Wille, Schoeller Electronics GmbH, DE
12:50 - 13:50	Mittagspause	
13:50	Workshop Teil 2	
13:50	AML - Aktiver Multilayer - Einbetttechnologie für aktive und passive Bauelemente	Thomas Hofmann, Hofmann Leiterplatten GmbH, DE
14:10	Die Innovation der "Embedding Technology" und der Weg zur Industrialisierung	Hannes Stahr, AT&S, AG, AT
14:30	Elektronische Bauelemente zuverlässig und kostengünstig einbetten mit der iBoard Technologie	Thomas Gottwald, Schweizer Electronic AG, DE
14:50	<p>Gruppendiskussion mit allen Sprechern des Workshops über Kosten- und Technologieentwicklungen in Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberflächenmontage im Vergleich zu eingebetteten Bauteilen • Arbeitsteilung zwischen Leiterplattenhersteller und Bestücker beim Einbetten von Bauteilen in Leiterplatten • Starre Leiterplatten zu flexiblen bzw. starr-flexiblen Leiterplatten • Zukünftige Design- und Bestückungstechnologien 	
15:50	Schlusswort und Kaffeepause. Zusammenstellung der Besuchsgruppen	
16:15	<p>Firmenbesichtigung der BuS Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leiterplattenhersteller, Material- und Prozesslieferanten und Leiterplattenentflechte haben die Möglichkeit, an einer Firmenbesichtigung der BuS Elektronik teilzunehmen. <i>Eine separate Anmeldung ist erforderlich</i> • Wettbewerber der BuS Elektronik können von einigen Bereichen bei der Firmenbesichtigung möglicherweise ausgeschlossen werden 	
17:45	Ende der Veranstaltung	

The EIPC is not responsible for the content and the presentation of the technical papers, which rests with the presenters.
Changes in the programme may occur, due to circumstances, for which the EIPC may not be held responsible.

Hintergrundinformation

Die Miniaturisierung von Bauteilen ermöglicht neue technologische Lösungen mit eingebetteten Bauteilen in Leiterplatten. Baugruppen mit Bauteilen, die in der „neutralen Phase“ einer Leiterplatte positioniert wurden, sind einer geringeren Stressbelastung ausgesetzt. Eine Verlagerung der Bauteilplatzierung von der herkömmlichen Bestückung zum Einbetten von Bauteilen in die Leiterplatten erfordert eine intensive Kommunikation zwischen den Bauteillieferanten, den LP-Entflechtern, den Basismateriallieferanten, den Leiterplattenherstellern und den Bestückern. Die Auswahl eines Basismaterials mit einem geringen Ausdehnungsfaktor und der richtigen Leiterplatten-Oberfläche, die eine zuverlässige Mehrfachlötlung mit erhöhten Temperaturen für bleifreie Lote zulassen, sind ebenfalls wichtige Fakten für eine qualitätsgerechte Fertigung von Baugruppen. Eine Kostenreduzierung durch Miniaturisierung ist eine Forderung zur Senkung der Gesamtkosten von Baugruppen.

Information über BuS Elektronik GmbH & Co. KG

Deloitte zeichnet ostdeutsche Unternehmen mit dem Axia-Award für Bestleistungen aus.

Am 21. Januar 2010 zeichnete Deloitte (*eine der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit einem breiten Spektrum in den Bereichen **Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance-Beratung***) im Berliner Hotel Adlon drei ostdeutsche Mittelständler mit dem Axia-Award für beispielhafte Unternehmensführung aus.

Die Preise gingen:

- An den IT-Telekommunikations-Anbieter KOMSA Kommunikation Sachsen,
- An den Biokraftstoffhersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie und
- An den Dienstleister für elektronische Baugruppen BuS Elektronik.

41 Firmen hatten sich beworben. Die Jury befand die Unternehmensführung der Sieger in je einem von drei Bereichen (Personal-, Innovations- und Kundenbeziehungsmanagement) für herausragend.

Sieger im Bereich Kundenmanagement: BuS Elektronik GmbH & Co. KG in Riesa

Bei der BuS Elektronik gilt der Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das zeigt sich zum einen darin, dass BuS keine fertigen Angebote bereithält, sondern Lösungen ausschließlich nach Kundenbedürfnissen entwickelt. Außerdem leistet sich das Unternehmen eine geradezu außergewöhnliche Transparenz. Potentiellen Kunden werden umfangreiche Kosten-Nutzen-Rechnungen vorgelegt, in denen ein Outsourcing von Leistungen an BuS mit einer Auslandsproduktion verglichen werden. Auftraggeber erhalten Einblick in die Preiskalkulation des Unternehmens und können sogar an Workshops teilnehmen, in denen BuS eigenes Fertigungs-Know-how weitergibt. Diese hervorstechenden Maßnahmen werden flankiert durch ein umfassendes Kundenmanagement mit Just-in-Time-Produktion, Auswertungen für den Kunden, Produkt-Redesign oder auch End-of-Life-Services.

Ort des Workshops:

BuS Elektronik GmbH & Co. KG

Bayern-und-Sachsen-Straße 1, 01589 Riesa, Deutschland

Telefon +49(0) 3525 600-6600, Telefax +49(0) 3525 600-6666

www.bus-elektronik.de

Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt

Hotel Referenz

Für Seminarteilnehmer, die vor dem Seminar ein Zimmer benötigen, wurde eine Vereinbarung mit dem Mercure Hotel Riesa getroffen. BuS Elektronik hat für eine begrenzte Anzahl von Zimmern einen Spezialpreis von € 56- inkl. Frühstück mit dem Hotel vereinbart. Bitte sprechen Sie das Hotel direkt an. Sie können anrufen +49 (0)3525 709-0 oder ein Fax schicken +49 (0)3525 709-999. Code-Wort ist: "BuS Elektronik".

Reservierungsfrist: 21. September 2010. Nach diesem Datum muss die Verfügbarkeit geprüft werden.

Mercure Hotel Riesa,

Bahnhofstraße 40, 01587 Riesa, Deutschland

mercure@magnet-riesa.de, www.accorhotels.com

Abendessen

Für Seminarteilnehmer, die am 5. Oktober übernachten werden, wird ein gemeinsames Abendessen geplant. Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung, falls Sie am Abendessen teilnehmen werden. Für die Teilnahme am Abendessen wird ein Beitrag von € 40.- berechnet.